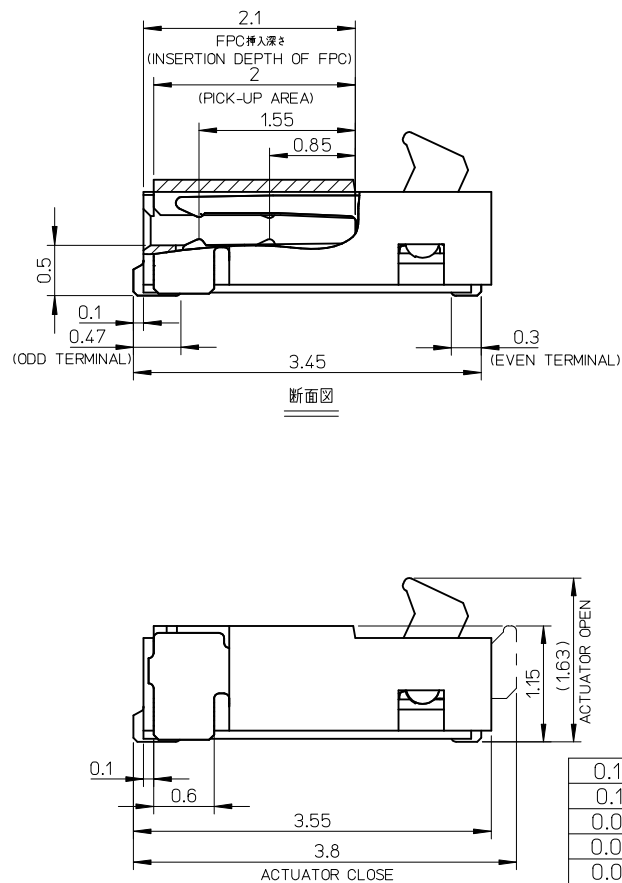
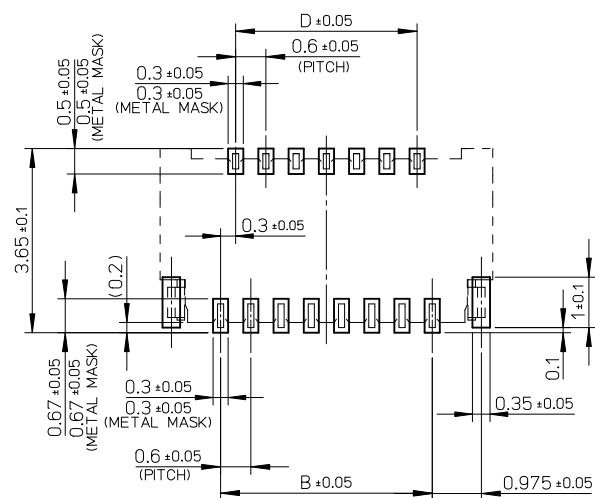




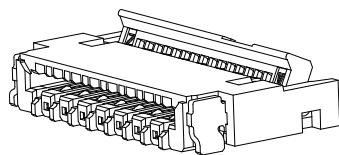
ELV AND RoHS COMPLIANT

0.125	14.4	16.95	15	17.4	502598-5191	51
0.112	12.6	15.15	13.2	15.6	502598-4591	45
0.098	10.8	13.35	11.4	13.8	502598-3991	39
0.085	9	11.55	9.6	12	502598-3391	33
0.077	7.8	10.35	8.4	10.8	502598-2991	29
0.072	7.2	9.75	7.8	10.2	502598-2791	27
0.068	6.6	9.15	7.2	9.6	502598-2591	25
0.063	6	8.55	6.6	9	502598-2391	23
重さ (g) WEIGHT(g)	D	C	B	A	EMBOSSD PACKAGE オーダー番号 ORDER NO.	極 数 CIRCUITS

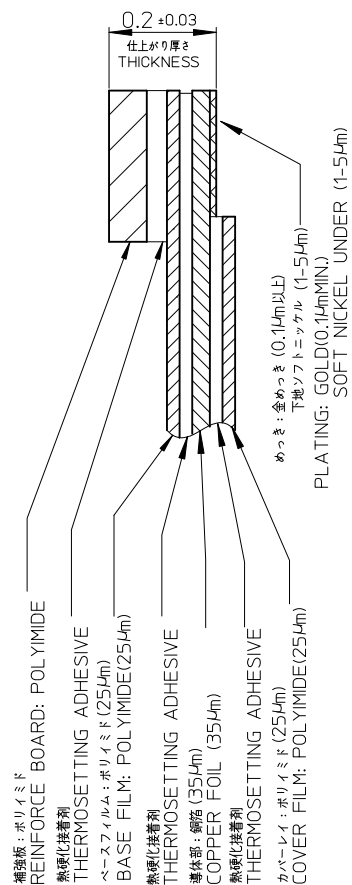
EN-02DA(021)



推奨基板寸法
RECOMMENDED P.W.B. PATTERN LAYOUT
推奨メタルマスク厚: $t=0.1\text{mm}$
RECOMMENDED METAL MASK THICKNESS: $t=0.1\text{mm}$

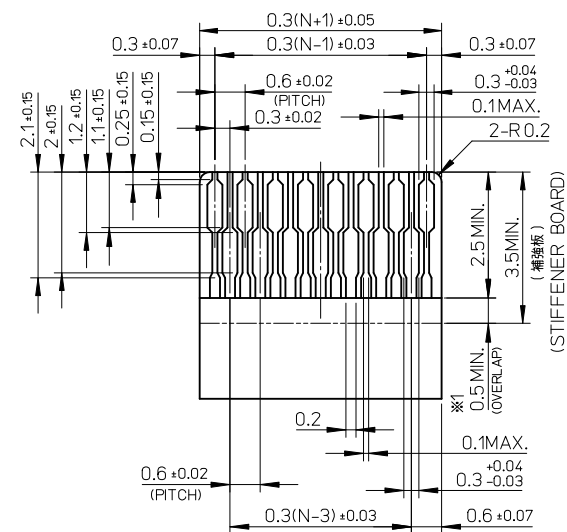


ISO VIEW (参考)



FPC構成推奨仕様

STRUCTURE OF FPC



N: 極数
N:CIRCUITS

適合する金めっきFPC推奨寸法
APPLICABLE FPC OF GOLD PATING
RECOMMENDED DIMENSION

(仕上がり厚さ: 0.2 ± 0.03)
(THICKNESS: 0.2 ± 0.03)

FPCについて:

抜き方向は、導体側から補強板側を推奨致します。
補強フィルム材質は、ポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化性接着剤を推奨致します。
尚、接着剤の接点部への付着は導通不良の原因になりますので、
染み出しが無い様、お願い致します。

ABOUT FPC:

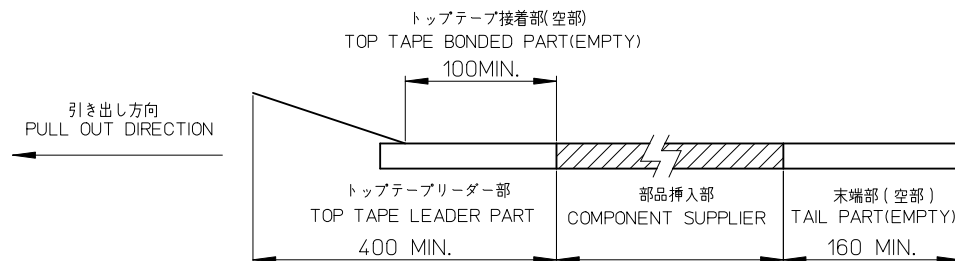
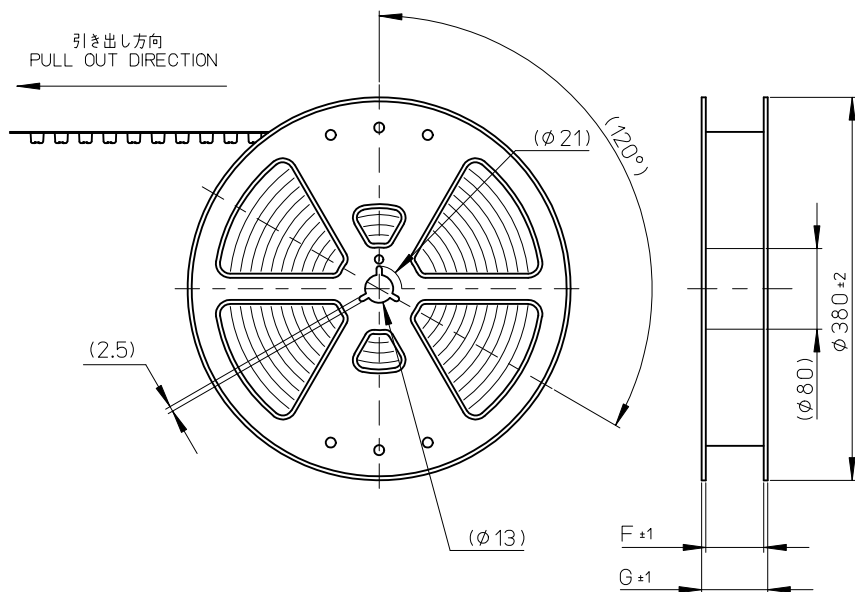
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION:
FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFNER FILM SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL:
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING AGENT
PLEASE PUT APPROPRIATE AMOUNT OF ADHESIVE
ADHERING BECAUSE THERE IS A POSSIBILITY THAT
THE EXTRA ADHESIVE CAUSES THE DEFECT IN
ELECTRICAL CONTINUITY.

※1 補強板の長さが図面通りに確保できない場合は、カバーレイと補強板のオーバーラップ寸法を0.5mm以上としてください。
WHEN STIFFENER BOARD DIMENSION CAN NOT SECURE AS DRAWING, PLEASE GIVE THE OVERLAP SIZE OF COVER FILM AND STIFFENER BOARD AS 0.5mm MINIMUM.

REVISED EC NO: J2012-0121 DRAWN:YUASEGAWA 2011/07/25 CHKD:K TAKAHASHI 2011/07/25 APPR:KMORI KAWA 2011/07/28	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ++	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY HONO	DATE 2009/07/21	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP HOUSING ASSY				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY HSHIMOYAMA	DATE 2009/07/21					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY KMORI KAWA	DATE 2009/07/21	MOLEX INCORPORATED DOCUMENT NO. SD-502598-001 SHEET NO. 2 OF 2				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO. SEE TABLE						
	REV	C	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				

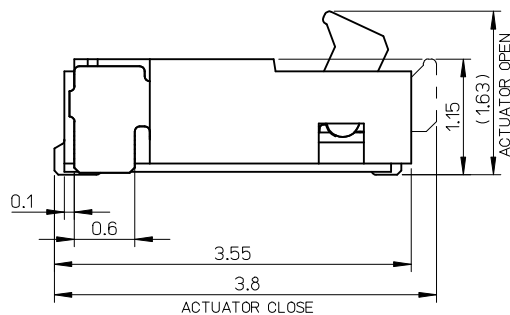
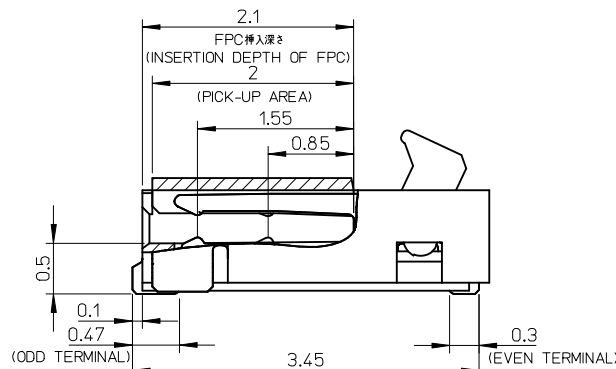
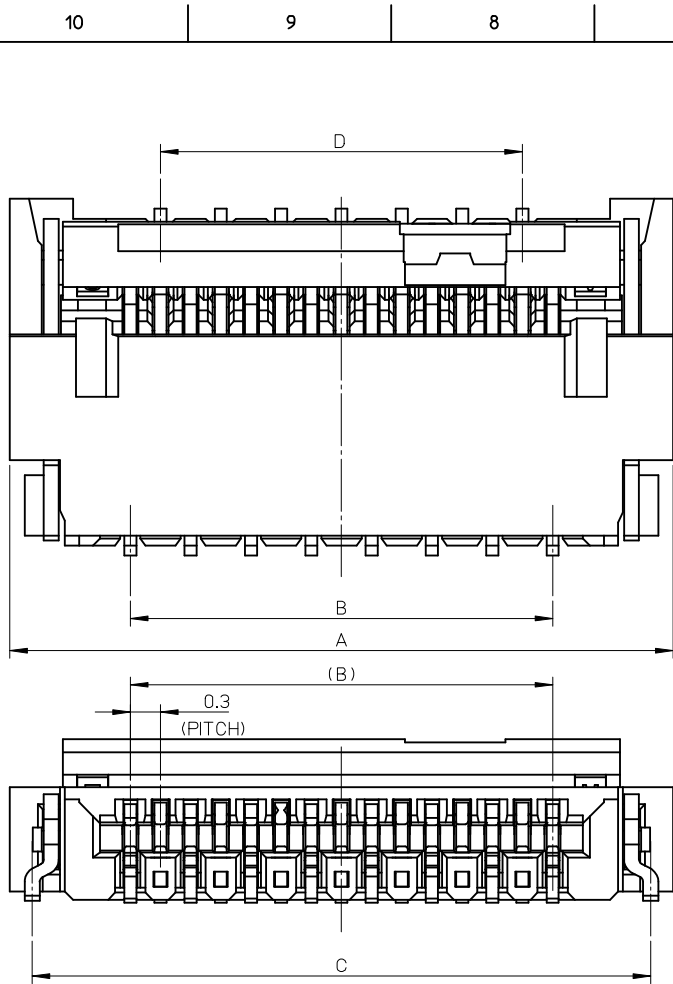
注記)
NOTES

- 1.製品番号502598-**11の詳細寸法は、製品単体図面を参照下さい。
IN THE PACKAGE PART NUMBER 502598-**11 DETAIL DIMENSIONS,
SEE SALES DRAWING FOR CONNECTOR.
- 2.梱包数量:3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000 PCS/REEL
- 3.リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH



- 4.カバーテープの剥離強度については、IEC60286-3に準拠
COVER TAPE PEEL FORCE IS DEFINED BY IEC 60286-3.
- 5.材料
MATERIAL
キャリアテープ:ポリスチレン(PS)
CARRIER TAPE:POLYSTYRENE(PS)
トップテープ:ポリエチレンテレフタレート(PET)、他
TOP TAPE :POLYETHYLENE TELEPHTHALATE(PET), OTHERS
リール:ポリスチレン(PS)
REEL:POLYSTYRENE(PS)
- 6.ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

REVISED EC NO: J2011-0028 DRWNG:HONO01 CHKD:SHIMOYAMA APPR:KMORIKAWA 2010/07/06 2009/07/21 2010/07/08	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± ---	DRAWN BY HONO	DATE 2009/07/21	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP TAPING PACKAGE (502598-**11 SERIES)				
		10 OVER 30 UNDER	± ---	CHECKED BY SHIMOYAMA	DATE 2009/07/21					
		30 OVER	± ---	APPROVED BY KMORIKAWA	DATE 2009/07/21	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502598-002		1 OF 2		
	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								



注記 NOTES:

1.材質 MATERIAL

ハウジング: LCP(液晶ポリマー)、白色、ガラス充填、UL94V-0
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER, WHITE (NATURAL)
GLASS FILLED, UL94V-0
アクチュエータ: ポリアミド樹脂
黒色、ガラス充填、UL94HB

ACTUATOR: POLYAMIDE
BLACK GLASS FILLED, UL94HB

ターミナル: 焼青銅 (t=0.12)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.12)

金具: 焼青銅 (t=0.15)
NAIL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)

2.めっき仕様 PLATING

ターミナル TERMINAL

接点部: 金めっき 0.1μm以上
CONTACT AREA: GOLD 0.1 MICROMETER MINIMUM

半田付け部: 金めっき
SOLDER TAIL AREA: GOLD

下地めっき: ニッケル 1.0μm以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

金具 NAIL
錫めっき 1.0μm以上
TIN PLATING 1.0 MICROMETER MINIMUM

下地めっき: ニッケル 1.0μm以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM

3.平坦度は、0.1ミリ以下とする。
TAILS COPLANARITY TO BE 0.1 MAXIMUM.

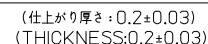
4.ELV及びRoHS適合品
ELV AND RoHS COMPLIANT

5.本製品は502598-**-91の端子材料変更品である。
THIS PRODUCT IS CHANGE OF TERMINAL MATERIAL
FOR 502598-**-91.

0.125	14.4	16.95	15	17.4	502598-5193	51
0.112	12.6	15.15	13.2	15.6	502598-4593	45
0.105	11.4	13.95	12.0	14.4	502598-4193	41
0.098	10.8	13.35	11.4	13.8	502598-3993	39
0.085	9	11.55	9.6	12	502598-3393	33
0.077	7.8	10.35	8.4	10.8	502598-2993	29
0.072	7.2	9.75	7.8	10.2	502598-2793	27
0.068	6.6	9.15	7.2	9.6	502598-2593	25
0.063	6	8.55	6.6	9	502598-2393	23
0.048	4.2	6.75	4.8	7.2	502598-1793	17
0.043	3.6	6.15	4.2	6.6	502598-1593	15
重さ (g) WEIGHT(g)	D	C	B	A	EMBOSSED PACKAGE オーダー番号 ORDER NO.	極数 CIRCUITS

CONNECTOR SERIES NO. 502598-**-21

REVISED EC NO: J2014-0146 DRAWN: KAGUMO CHKD: TAKAHASHI APPR: YNOGAWA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY KMIYAHARA	DATE 2012/07/18	TITLE 0.3 FPC CONN. BACK FLIP HOUSING ASSY molex				
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY KTAKAHASHI	DATE 2012/07/18					
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY KMORIKAWA	DATE 2012/08/01					
		ANGULAR ±1 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO.		
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-502598-003		1 OF 2		
REV		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								



PLEASE PUT APPROPRIATE AMOUNT OF ADHESIVE ON ADHEREND BECAUSE THERE IS A POSSIBILITY THAT THE EXTRA ADHESIVE CAUSES THE DEFECT IN ELECTRICAL CONTINUITY.

tb_frame_A3_J_AM_S
Rev G 2012/01/25



**Стандарт
Электрон
Связь**

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331